

半導體封裝技術，微學程(9學分)

ENGS-U-MP-011

配當年：115學年度

學程描述：

從此學程中，學生可以由半導體材料的最基礎知識出發，並逐步拓展至半導體封裝的核心與專業知識，最終學習到半導體封裝技術中的實際應用。取得學程後，對於欲進入半導體封裝及測試業的學生在就業上已具備該行業之基礎專業知識，輔助學生快速進入該產業。對於立志從事自然及工程科學研究發展服務業的學生也可持續朝此方向繼續進行研究與探索。

課程組合：

必選修	課程編碼	科目名稱	學分	課程群/分類
必修	MSE1000	材料科學導論(一)	3	1.基礎
必修	MSE1010	材料科學導論(二)	3	1.基礎
選修	MSE4073	三維積體封裝技術	3	2.進階
選修	MSE4092	功率半導體封裝技術	3	2.進階

取得資格總學分： 9

必修學分數： 6

選修學分數： 3

對應產業類別：

C26	電子零組件製造業
C00	製造業
C27	電腦、電子產品及光學製品製造業
C29	機械設備製造業
C28	電力設備及配備製造業

學程修課規則：

一、修讀對象：

本校學士班對半導體封裝技術感興趣或有意從事封裝產業之學生，不開放進修部學生及碩士班以上申請。

二、取得微學程的修業規定：

(一)取得微學程之最低學分數：9學分，

完成基礎/核心必修6學分，進階及應用/實作課程至少選修1門課程，合計通過3門課程，共9學分，始取得「半導體封裝技術」微學程資格。

(二)承認微學程之科目學分

1. 科目名稱或內容相同者，承認學分數不得重複計算。

2. 修習之科目實際學分數超過微學程承認學分數，則以承認學分數計算。如實際學分數低於微學程承認學分數，則以實際學分數計算。

3. 未列入本微學程課程規劃表內之科目，學生得持課程內容證明申請採計學分，經「半導體封裝技術微學程工作小組」審議通過後，採認為本微學程之科目學分。

(三)學生修滿規定之科目學分者，得依逢甲大學跨領域學程設置要點第7點規定，經本微學程審查修畢學分確認後，由學校發給微學程證明書。

三、對接產業類別：

汽車與機車產業、家電與智慧家居、電子與通訊設備、電動工具與手持設備、醫療與健康設備

管理單位：工程與科學學院 / 材料科學與工程學系